

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-020

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度。具体内容如下：

为促进公司持续发展，满足公司生产经营需求，公司拟向金融机构申请不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意提

请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），并办理相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日